

公司代码：688313

公司简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为458,802,328股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,470,058.20元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.13%。不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	仕佳光子	688313	/

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	钟飞	路亮
办公地址	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
电话	0392-2298668	0392-2298668
电子信箱	ir@sjphotons.com	ir@sjphotons.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。报告期内，公司主营业务未发生重大变动。

公司秉承“以芯为本”的理念，保持对光芯片及器件的持续研发投入，不断强化技术创新、掌握自主芯片的核心技术。经过多年的研发和产业化积累，针对光通信行业核心的芯片环节，公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的 IDM 全流程业务体系，应用于多款光芯片开发，突破一系列关键技术。同时，针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势，公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累，持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势，通过不断改进各产品环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力。依托光芯片及器件、室内光缆以及线缆材料协同发展，公司在光通信行业的综合实力稳步提升。

2、公司主要产品情况

公司主要产品包括光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大类。光芯片及器件产品包括 PLC 分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列产品、光纤连接器和隔离器。公司上述产品主要应用于光纤接入网、数据中心、5G 等场景。公司紧紧围绕光纤接入网、数据中心及 5G 建设等应用领域，已形成良好的产品布局和核心技术积累，在 AWG 芯片以及 DFB 激光器芯片方面已形成明显突破，公司产品演进路线符合行业发展趋势，能够更好地适应行业下一代产品的演进方向。

(1) PLC 分路器芯片系列产品

平面光波导（PLC）分路器芯片主要用来实现相同波长信号的分路与合路，应用于光纤到户建设，是光纤到户（FTTH）网络的核心无源芯片。公司目前 PLC 分路器芯片系列产品包括 PLC 分路器晶圆、PLC 分路器芯片以及 PLC 分路器器件，公司已成功实现 20 余种规格的 PLC 分路器芯片国产化，上述产品已形成全规格、多品类的量产能力和规模化销售。

(2) AWG 芯片系列产品

阵列波导光栅（AWG）芯片是波分复用（WDM）系统的核心无源芯片，能在发送端将不同波长的光信号复用，并耦合到同一根光纤中进行传输，在接收端又将组合波长解复用。公司目前 AWG 芯片系列产品包括数据中心 AWG 芯片产品、骨干网城域网扩容用的密集波分复用(DWDM)设备的 AWG 芯片产品和用于 5G 扩容的波分复用（WDM）器件（滤波片方案）。

(3) DFB 激光器芯片系列产品

分布反馈（DFB）激光器芯片被广泛应用于高速光信息传输领域，是数据中心、4G/5G 无线通信网和接入网中的关键有源光发射芯片。经过持续研发投入，公司在 DFB 激光器芯片领域已经逐步形成包括 2.5G DFB 激光器芯片、10G DFB 激光器芯片、大功率连续波（CW）DFB 激光器芯片，以及 DFB 激光器器件在内的一系列产品。25G DFB 激光器芯片处于送样阶段。

(4) 公司光纤连接器

光纤连接器属于一种光无源器件，能够在其他各类光器件及设备之间进行可拆卸（活动）连接，以使发射器输出的光信号能最大限度地耦合到接收器中去。公司目前的光纤连接器产品包括用于 FTTH 布线的引入光缆连接器、用于 5G 基站射频拉远光缆连接器、用于数据中心高集成化的多芯束（MPO/MTP）连接器。

(5) 光隔离器

光隔离器是允许光向一个方向通过而阻止向相反方向通过的无源光器件，其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。作用是对光的方向进行限制，使光只能单方向传输，通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离，提高光波传输效率。公司目前的自由空间隔离器主要用于隔离远端光路反射的光对有源芯片的影响，隔离设备端反射的光对 DFB 芯片的影响。

(6) 室内光缆

室内光缆是根据室内场景的应用需求，选用适配的材料，通过一定的涂覆、挤塑工艺将光纤包裹，再由一定数量的光纤按照不同结构组成缆芯，加包多层保护层，最终实现光信号的正常传输。目前公司生产的室内光缆主要运用在电信、数据通信等领域。

(7) 线缆材料

线缆材料主要采用高分子基础树脂原料进行改性配方设计、增强等加工工艺，改变其性质，从而使强度、低摩擦等方面的性能得到显著提高。产品广泛应用于通信线缆、电子电气线缆、汽车线缆、电力线缆等产品的绝缘和护套材料。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司主要通过对接下游厂家及终端用户、以直销方式进行销售。公司主要通过现有客户推荐、展会、宣传、客户经理对业务领域及渠道的拓展等方式寻求新客户。公司市场部下设销售部与市场支持部，销售部主要负责对接客户，参与新客户的开发与老客户的维护，并将客户需求及时反馈给市场支持部。市场支持部负责在接到订单需求反馈后及时统筹生产、物资等相关部门，同时承担跟单、售后、技术支持、市场信息收集与调研、定价管理、产品宣传等工作。在产品定价策略上，公司结合市场供求状态、产品的技术先进性、制造工艺的复杂程度、产品制造成本等因素，经过与客户谈判协商后，确定产品价格。

2、生产模式

公司光纤连接器、室内光缆、线缆材料等产品为定制化产品，公司采用“以销定产”模式，在取得客户订单后依据订单要求投料生产。公司 PLC 分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品的生产周期较长，有一定的交付压力，并且在产品规格经客户导入定型后，变化情况较小，公司根据市场情况或客户预期订单提前制订计划做生产储备。其中，公司晶圆、芯片、器件生产模式属于垂直一体化的 IDM 模式，覆盖了芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试全流程，设计、制造等环节协同优化，有利于公司充分发掘技术潜力，也有利于公司率先开发并推行新技术。

3、采购模式

在供应商选择方面，公司制定了供应商管理制度，对供应商选定程序、价格控制机制、跟进措施进行了详细的规定。物资部通过展会、行业介绍等方式寻找潜在的供应商，组织对供应商的能力进行调查，收集供应商技术资料等，要求供应商提供样品，送研发部或技术部进行测试和验证。质量管理部根据物资部提交的供应商资料、研发部或技术部测试和验证的结果等，综合进行判定并确定合格供应商。

公司根据生产计划，综合考虑产品定价、产品质量、付款方式、供货能力等诸多因素，经审批后与相关供应商订立采购协议。同时，公司持续监控及评估现有及潜在供应商能否满足公司的要求及标准。公司对供应商进行定期考核，综合考虑原材料质量、交货期、后期服务、价格等因素，进行动态管理。

4、研发模式

公司以市场需求导向为主，利用无源和有源两大工艺平台能力和产业化技术，结合业务结构、行业特点，改造优化现有产品及确定新产品研发方向，并成立研发项目组。公司研发活动由研发项目经理牵头，研发部、工程技术部、市场部、质量管理部、物资部等协同配合。

对于新产品开发，项目组在样品阶段根据产品设计和开发计划书的安排，组织有关部门人员对设计和开发方案进行评审。设计方案评审通过后，项目组对设计开发进行验证和评审工作。

样品研发成功后，公司验证产品批量重复性、可靠性等性能，当内部评审产品性能及可靠性达到研发目标时，与销售部门一同将样品送至客户进行可靠性测试等验证，并根据客户反馈报告，进行设计及工艺改进，实现产品定型，完成产品导入。在新产品逐步量产过程中，研发部与工程部持续开展中等规模工程批验证，进行工艺改进及良率提升，直至形成稳定的大规模批量生产能力。考虑到光芯片研发周期长，不确定性因素较多，为提升研发效率，公司在光芯片领域积极与国内主流科研机构开展合作研发。自 2010 年 12 月以来，公司与中科院半导体所保持长期良好的合作研发关系。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。

公司所处行业为光通信行业。光通信行业包括基础构件（光芯片、光器件/光模块、光纤光缆）和设备集成，最终应用领域主要为 5G 移动通信承载、骨干/城域网扩容、数据中心光互联以及光纤接入网等，是典型的技术密集型、人才密集型、资金设备密集型产业。

光器件是由光芯片、光纤及金属连线组合封装在一起，完成单项或少数几项功能的混合集成器件。光模块是以光器件为核心，增加一些电路部分和结构功能件等完成相应功能的单元。光模块通过光纤光缆与设备实现光信息传输功能并提供运营服务。

光芯片、光器件/光模块产业位于光通信产业的上游，为中下游系统设备商提供器件、模块等产品，其性能的好坏直接影响到光纤通信系统最终的质量。

在光通信产业中，国内企业目前在光通信设备、光纤光缆等领域已经有了长足的发展，在全球范围内都有着较强的竞争力，光器件/光模块产业也取得了迅猛发展。然而在核心光芯片领域，我国仍然处于追逐者的位置。据工信部《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》，目前我国光通信高端核心芯片 90% 以上需要进口，是发展最为薄弱的环节。

光芯片处于产业链的核心位置，技术要求高，工艺流程复杂，存在研发周期长、投入大、风险高等特点，具有较高的进入壁垒，占据了产业链的价值制高点。尤其近年来，伴随着我国对外贸易摩擦频发，光芯片的重要性凸显，严重依赖进口的现状已经对我国光通信产业链发展造成了极高的安全风险。

光芯片的研发生产过程涉及半导体材料、半导体物理、量子力学、固体物理学、材料学、激光原理与技术等诸多学科，需要综合掌握外延、微纳加工、封装、可靠性等多领域技术工艺，并加以整合集成，属于技术密集型行业。随着信息需求的不断增大，要求的光芯片需求朝着更高功率、高快速率、光电集成等发展趋势；新产品、新应用的不断涌现，对光芯片的制造封装工艺等方面提出了更高的技术要求，同时光芯片差别化应用领域的快速拓展，激光雷达、气体传感、生物监测、环境监测等跨领域的产品需求，对设计对接、应用对接都有很高的要求，在一些传统领域的量产导入等方面，传统光通信企业可靠性要求等非常高，需要较长的导入时间。因此，本行业对新进入者有较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司秉承“以芯为本”的理念，保持对光芯片及器件的持续研发投入，努力打造自主芯片的核心能力，目前已发展成为国内光通信行业主要光芯片及器件企业之一。

在互联网流量持续增长和带宽需求的驱动下，2020年3月，中央正式提出加快以5G与数据中心为代表的新型基础设施建设，有力地带动光芯片与器件产业的发展。网络建设在新基建中扮演着至关重要的角色。公司目前主要产品对应的细分市场包括数据中心光互联、光纤接入网、骨干/城域网扩容以及5G移动通信承载等。

云服务需求带动的数据中心市场将成为光通信行业的主要增长动力之一。在数据中心内部互联以及数据中心互联（DCI网络）需求的推动下，公司的数据中心AWG器件（用于100G-400G数据中心光模块）、多芯束光纤连接器（及其对应的室内光缆、线缆材料）和隔离器（用于数据中心光模块）出货量和销售额都有大幅的增加。

我国光纤接入的普及率已经达到较高水平市场，但海外光纤到户普及率仍然处于较低水平，受此趋势影响，公司大力拓展海外业务，报告期内，PLC分路器芯片系列产品收入基本保持稳定，但海外销售的PLC分路器器件占比进一步提升。中国三大运营商正全面推进下一代光纤接入千兆网络建设，公司开发的针对光纤接入网应用的DFB激光器芯片系列产品累计出货量已经超过百万量级，实现里程碑式突破。

随着数据中心、5G建设推进，终端数据量激增也将推动骨干网/城域网扩容，100G及以上的DWDM器件/模块需求将快速提升。用于相干通信的150GHz 40波，100GHz 60波及超大带宽产品等新的应用需求不断涌现，部分产品已经小批量出货。随着技术的演进，波分复用技术的应用不断下沉，逐步应用到城域网、接入网、数据中心以及5G前传等领域，公司能够在未来波分复用技术的广泛应用中赢得主动。

报告期内，全球 5G 建设继续加速。据工信部数据，截至 2020 年底，中国已累计开通 5G 基站 71.8 万个，5G 手机终端连接数突破 2 亿户。目前全球拥有 5G 网络的城市数量已达 1336 个，在过去一年中增长了 350%，全球超过 30% 的国家已实现 5G 商用。5G 建设发展带来对无线承载网设备及光器件的新增需求。据工信部目标，“十四五”期间，我们将建成系统完备的 5G 网络。另据 Heavy Reading 预测，未来五年全球电信运营商在 5G 网络投资将超过 2000 亿美元。公司正在积极开发适用于 5G 的 25G DFB 激光器芯片产品，已量产出货的用于 5G 的波分复用 WDM 器件（滤波片方案）。

在 5G 和数据中心建设的带动下，公司 5G 通用的基站用射频拉远光缆正按照 5G 建设的进度逐步形成批量化销售，室内光缆和线缆材料业务也保持一定幅度的增长。

报告期内，美国商务部发布“实体清单”迫使国内通信设备厂家面临前所未有的挑战，给我国 5G 移动通信和光电子等产业发展带来了极大的不确定性和不稳定性。国产化替代不管是国家层面，还是企业层面，都是迫切的。公司凭借从芯片设计，晶圆制造、芯片加工到封装测试的自主全产业链流程能力，在国产化替代中，可以更好的把握这个趋势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速发展和传统产业数字化的转型，全球数据量呈现几何级增长。报告期内，受疫情影响，在家办公和在线教育更进一步增大对数据流量的需求，带动亚洲、欧洲和南美洲等多地的光纤接入网市场需求；中国的数据中心、5G 和下一代光纤接入网的新基建快速推进带动了光通信市场的增长；全球都在加大对光通信基础设施的建设。光通信行业受到数据流量需求的拉动，各类业务场景的增长形势都很好，未来光通信行业将保持持续增长。

根据和弦产业研究中心的预测，随着阿里巴巴、腾讯等数据中心市场的快速扩充，以及电信市场中 5G 的规模部署，国内光器件市场将迎来新的增长周期，预计未来五年国内光器件市场（含光芯片、光器件、光模块）保持快速增长。5G、大数据、人工智能、工业互联网等信息基础设施中大量使用光器件产品，有力地带动光器件产业的持续发展。光器件将向高速宽带化、集成小型化、可调智能化、光电融合化，以及低功耗成本等特征演进。

在数据中心领域，100Gb/s 光模块处于市场的持续增长需求阶段，400Gb/s 光模块从 2019 年起开始批量推向市场。在数据中心内部互联以及数据中心互联（DCI 网络）需求的推动下，光模块（及其对应的光芯片、光器件等）、光纤连接器（及其对应的室内光缆、线缆材料）出货量、销售额预计都将有显著增加。

在新一轮 5G 建设带动下，由于 5G 频谱频率上升，信号穿透建筑物的衰减较大，建站密度与 4G 基站相比将更高；5G 基站架构从 4G 的前传—回传演进到前传—中传—回传，需要的连接明显增加。根据测算，就光模块而言，单个基站需要的光模块数有望达 8—10 个，较 4G 基站有所增加，对应的光纤连接器需求也将随之增加。光通信行业中 5G 相关的光设备、光模块、光器件（及其对应的光芯片等）、光纤连接器（及其对应的室内光缆、线缆材料）出货量、销售额预计都将有显著的增加。

安永近日发布的《全球光通信产业白皮书》中指出，光通信产业在技术驱动代际演进和市场拉动网络变革升级作用下掀起新一轮发展机遇，推动“光联万物”时代的到来，也为第五代固网通信（F5G）的发展赋予了无限潜力，进而为万物互联、数字经济奠定了扎实的基础，有望撬动万亿市场空间。

在新一代高速宽带接入、数据中心及 5G 建设驱动下，光通信行业将迎来新一轮技术、产品升级，DFB 激光器芯片、AWG 芯片及其他光电集成芯片需求增长迅速，光纤连接器、室内光缆及线缆材料亦将持续增长。宽带、高速、高密度收发及传输将是光通信及数据通信未来发展趋势。作为核心支撑的光器件也将向高速宽带化、集成小型化、可调智能化、光电融合化，以及低功耗成本等特征演进。在光通信及数据中心传输流量爆炸式增长的推动下，有源器件、模块经历了从 2.5G、10G、100G 快速升级，并向 400G、800G 演进。DFB 激光器芯片亦从 2.5G、10G、25G 发展。同时，在涉及硅光技术的光收发器件中，高功率、小发散角 CW DFB 激光器芯片也不可或缺。因此，系统掌握 DFB 激光器外延技术、光栅制造核心技术，将是适应未来多应用场景产品升级的关键所在。

随着流量的快速增长和技术的演进，波分复用技术的应用不断下沉，逐步应用到城域网、接入网、数据中心以及 5G 前传等领域。在此过程中，掌握粗波分复用（CWDM）、局域网（LAN）、循环型（Cyclic）小型化 AWG 芯片相关技术的企业，能够在未来波分复用技术的广泛应用中赢得主动。

基于硅光技术的共封装光学(CPO)也被业界所认可，在未来十年，CPO 将成为云提供商数据中心的主导使能技术。到 2030 年，63%的 CPO 产品收入将来自该应用市场。随着机器间和大楼间数据通信的数据速率超过 400G，传统的可插拔光学器件和新的板载光学器件在成本效益方面将很难赶上 CPO。在数据中心市场中，主要设备制造商和大型数据中心用户正在积极开发基于 CPO 的光学引擎和开关/光学组合。围绕硅光及硅光的配套资源成为新一代光通信模块中的重要技术点，我司下一步将重点发展硅光配套的光源芯片和器件、硅基端面光纤耦合技术、硅基偏振复用

技术、硅基波分复用技术等一系列硅光子集成芯片关键技术。

随着新冠肺炎疫情逐步得到控制，全球经济逐步恢复正常，运营商在光纤接入网、5G 建设、骨干网/城域网扩容方面将步入正轨；云厂商方面，受到在线应用的持续推进，视频、直播等在线业务的推动将进一步推动更多的数据中心建设，带来更多光芯片和器件的需求。全球光通信市场将进入新的增长期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,499,392,347.62	993,319,861.21	50.95	1,124,135,413.46
营业收入	671,598,071.04	546,320,000.56	22.93	517,904,537.53
归属于上市公司股东的净利润	38,067,828.32	-1,583,316.54	2,504.31	-11,967,982.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,262,816.05	-24,880,292.68	141.25	-25,904,704.74
归属于上市公司股东的净资产	1,153,682,652.25	666,305,404.53	73.15	642,163,334.96
经营活动产生的现金流量净额	35,307,156.90	66,232,826.67	-46.69	22,187,139.58
基本每股收益(元/股)	0.0889	-0.0039	2,379.49	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.0889	-0.0039	2,379.49	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	4.55	-0.24	增加4.79个百分点	-1.91
研发投入占营业收入的比例(%)	9.38	10.91	减少1.53个百分点	9.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	121,675,994.60	206,223,544.84	171,719,644.45	171,978,887.15
归属于上市公司股东的净利润	10,578,907.40	17,572,149.53	8,259,311.71	1,657,459.68
归属于上市公司股	5,455,649.51	13,474,628.14	4,439,242.00	-13,106,703.60

东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	14,455,132.12	-9,133,666.31	19,919,645.21	10,066,045.88

第四季度营业收入较第三季度略有增长。第四季度起，公司产品受 5G 建设和数据中心建设放缓等行业周期因素影响，叠加毛利率较低的线缆材料收入占比上升等因素影响，对公司的毛利率和营业毛利金额产生一定影响，第四季度营业毛利金额较第三季度下降 1,590 万元。同时，公司在第四季度对应收账款坏账准备、存货跌价准备等均进行了更为审慎的判断，第四季度计提的信用减值损失、资产减值损失较第三季度合计增加 679.6 万元。受上述因素影响，公司第四季度扣非前后归属于上市公司股东的净利润较第三季度都有较大幅度的下滑。尽管如此，得益于应收账款的严格管理以及存货的消化，公司经营活动现金流情况仍然维持着较好态势。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)								12,166
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								10,452
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
郑州仕佳通信 科技有限公司	0	102,629,667	22.37	102,629,667	102,629,667	无	0	境内 非国 有法 人

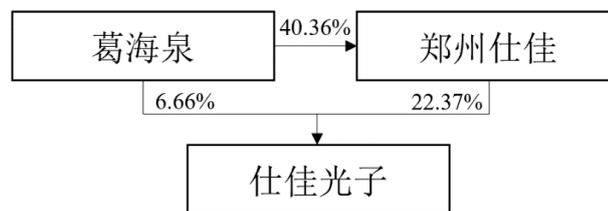
嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙）	0	31,950,000	6.96	31,950,000	31,950,000	无	0	境内非国有法人
葛海泉	0	30,541,172	6.66	30,541,172	30,541,172	无	0	境内自然人
鹤壁投资集团有限公司	0	30,000,060	6.54	30,000,060	30,000,060	无	0	国有法人
前海股权投资基金（有限合伙）	0	25,000,000	5.45	25,000,000	25,000,000	无	0	境内非国有法人
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	0	16,981,461	3.70	16,981,461	16,981,461	无	0	境内非国有法人
嘉兴诚豫投资合伙企业（有限合伙）	0	14,850,000	3.24	14,850,000	14,850,000	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	0	11,250,040	2.45	11,250,040	11,250,040	无	0	境内非国有法人
北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）	0	11,160,000	2.43	11,160,000	11,160,000	无	0	境内非国有法人
河南创业投资股份有限公司	0	10,000,080	2.18	10,000,080	10,000,080	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、葛海泉直接持有公司 6.66%的股份，通过郑州仕佳间接控制公司 22.37%的股份，合计控制公司 29.03%的股份，构成一致行动关系。2、丁建华直接担任北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，丁建华控制的北京普惠正通投资有限公司管理的北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）担任安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，构成一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

适用 不适用

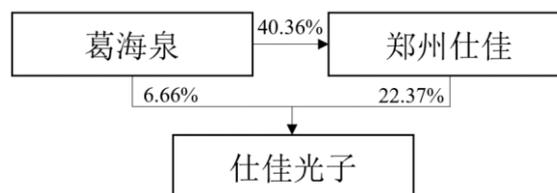
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司实现营业总收入 67,159.81 万元，同比增长 22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,806.78 万元，同比增长 2504.31%；报告期末，公司总资产 149,939.23 万元，较报告期期初增长 50.95%；归属于上市公司股东的所有者权益 115,368.27 万元，较报告期期初增长 73.15%。报告期内，公司的主营业务持续保持光芯片和器件、室内光缆和线缆材料三类业务。主营业务收入 65,514.92 万元，占比 97.55%，非主营业务收入 1,644.89 万元，占比 2.45%。其中，光芯片及器件产品收入 31,520.57 万元，同比 2019 年增长 46.11%；室内光缆产品收入 18,108.74 万元，同比 2019 年增长 8.89%；线缆材料产品收入 15,885.61 万元，同比 2019 年增长 3.80%。

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司纳入合并财务报表范围的子公司，分别为河南杰科新材料有限公司、河南仕佳光电子器件有限公司、河南仕佳电子技术有限公司、河南仕佳信息技术研究院有限公司、武汉仕佳光电技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限公司、SJ PHOTONS TECHNOLOGY AMERICA INC.、无锡杰科塑业有限公司、河南仕佳通信科技有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司。合并财务报表范围及其变化情况，详见本报告第十一节、八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益。